

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006年5月11日 (11.05.2006)

PCT

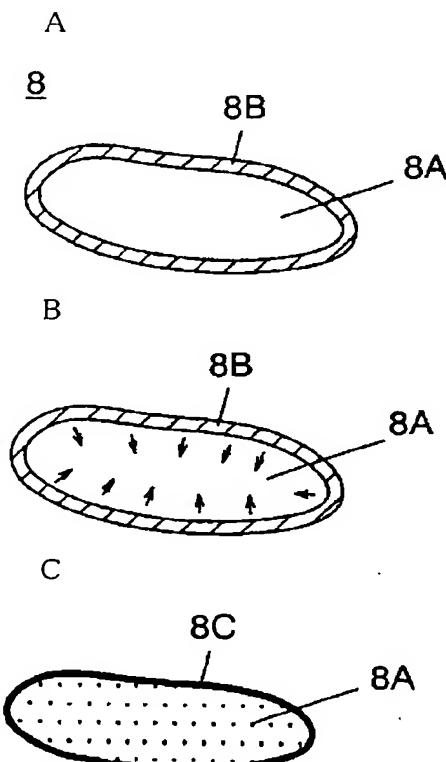
(10) 国際公開番号
WO 2006/049069 A1

- (51) 国際特許分類:
H05K 3/34 (2006.01) *B23K 35/363 (2006.01)*
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/019749
- (22) 国際出願日: 2005年10月27日 (27.10.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-320232 2004年11月4日 (04.11.2004) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 前田 憲 (MAEDA, Tadashi). 境 忠彦 (SAKAI, Tadahiko).
- (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1006 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

[続葉有]

(54) Title: PASTE FOR SOLDERING AND SOLDERING METHOD USING THE SAME

(54) 発明の名称: はんだ接合用ペーストおよびこれを用いたはんだ接合方法



(57) Abstract: A flux having a metal powder incorporated therein which is used between a bump and a circuit electrode in the mounting of electronic parts by soldering, wherein the metal powder comprises a core metal formed with a metal such as tin or zinc and a surface metal containing gold, silver or the like covering the surface of the core metal. A soldering method using the above flux is free from the retention after reflow of a metal powder as a residue in a state where the metal powder is prone to migrate, and thus can combine good soldering characteristics and good electric insulation.

(57) 要約: はんだ接合による電子部品実装時にバンプと回路電極との間に介在させて用いる金属粉入りのフラックスを提供する。金属粉は、錫や亜鉛などの金属で形成されたコア金属とこのコア金属の表面を被覆する金や銀などを含む表面金属とを有している。これにより、リフロー後に金属粉がマイグレーションを起こしやすい状態で残渣として残留することがなく、はんだ接合性と絶縁性の確保を両立させることができる。



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイド」を参照。

添付公開書類:

- 国際調査報告書